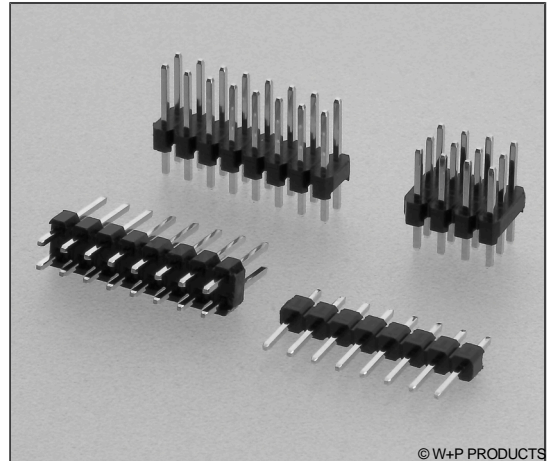


943 / 944 / 945

Stiftleisten RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig
Pin Headers, 2.54mm Pitch, Straight, 1/2/3 Rows

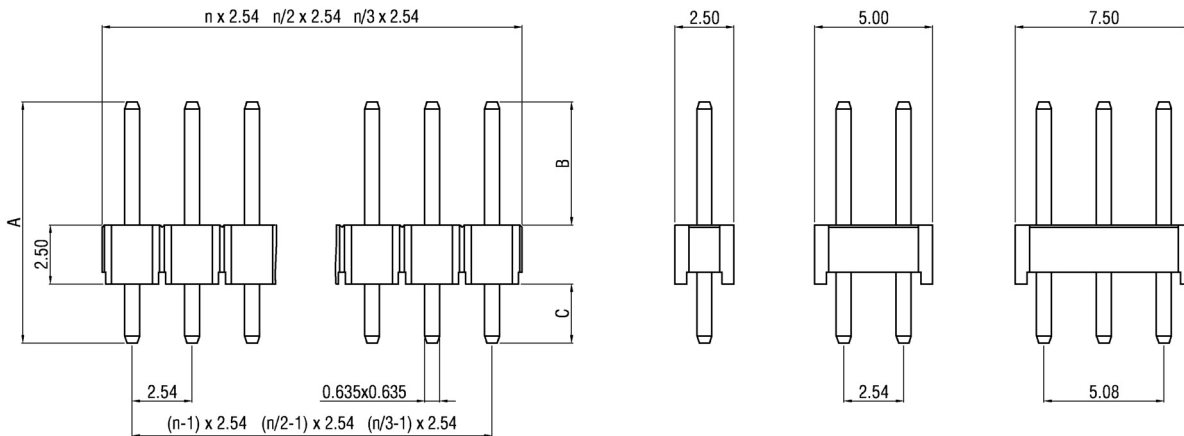
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
153 154 157 159 160/162 349 624 etc.
Weitere siehe Kapitel B
Please see ch. B for more



PCB Layouts und Detailzeichnungen s. tech. Informationen / Seite A12
Please note tech. information / page A12 for PCB layouts and detailed drawings.

Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*
944	10	010	00
Gestanzte/geprägte Kontakte <i>Stamped/formed contacts</i>	10 A=10,20 B=5,20 C=2,50mm	001-050 Einreihig <i>Single row</i>	00 Au flash
943 Einreihig <i>Single row</i>	11 A=10,80 B=5,80 C=2,50mm	004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	110 Sel. Au 0,25µm / Au flash
944 Zweireihig <i>Double row</i>	12 A=11,30 B=5,50 C=3,30mm	009-120 Dreireihig <i>Triple row</i>	130 Sel. Au 0,75µm / Au flash
945 Dreireihig <i>Triple row</i>	13 A=12,60 B=6,80 C=3,30mm		50 Sn
	14 A=13,90 B=8,10 C=3,30mm		66 Sel. Au flash / Sn
	15 A=14,70 B=8,90 C=3,30mm		610 Sel. Au 0,25µm / Sn
	16 A=17,70 B=11,90 C=3,30mm		80 Sel. Au 0,75µm / Sn
	17 A=19,80 B=14,00 C=3,30mm		Au flash <= 0,1µm
	18 A=21,60 B=15,80 C=3,30mm		Au flash <= 0,1µm
	19 A=22,80 B=17,00 C=3,30mm		
	20 A=24,90 B=19,10 C=3,30mm		
	A/B/C Gesamtlänge & Wunschmaße <i>Total length & Dimensions</i>		

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl.
Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie
weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.
Bestellseite "Sonderbestückungen bei Stiftleisten" unter
Techn. Informationen.

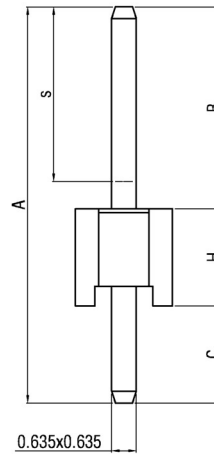
We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more dimensions on request. Order page "Customer-specific Pin Configurations" in Technical Information.

* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.

Gerade Stiftleisten

- A : Gesamtstiftlänge
- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

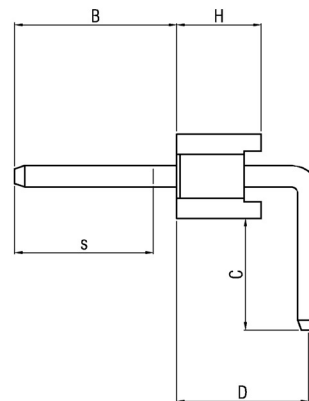
Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



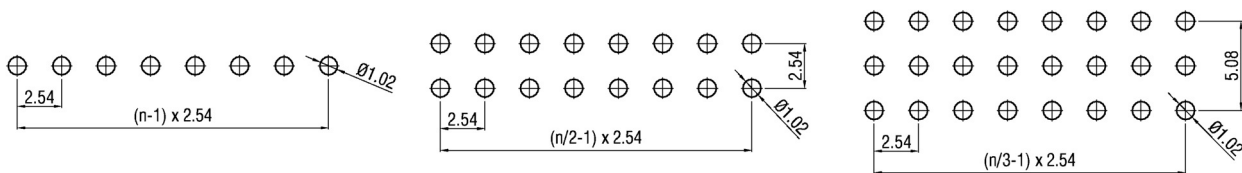
Gewinkelte Stiftleisten

- B : Länge Steckseite
- C : Länge Lötseite
- D : Abstand zu Steckseite
- H : Höhe Isolierkörper
- s : Bereich der sel. Veredelung

Messpunkt für **s** bei 2-4mm von der Stiftspitze.



PCB Layouts



Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min



Informationen zum Wellen-Lötverfahren

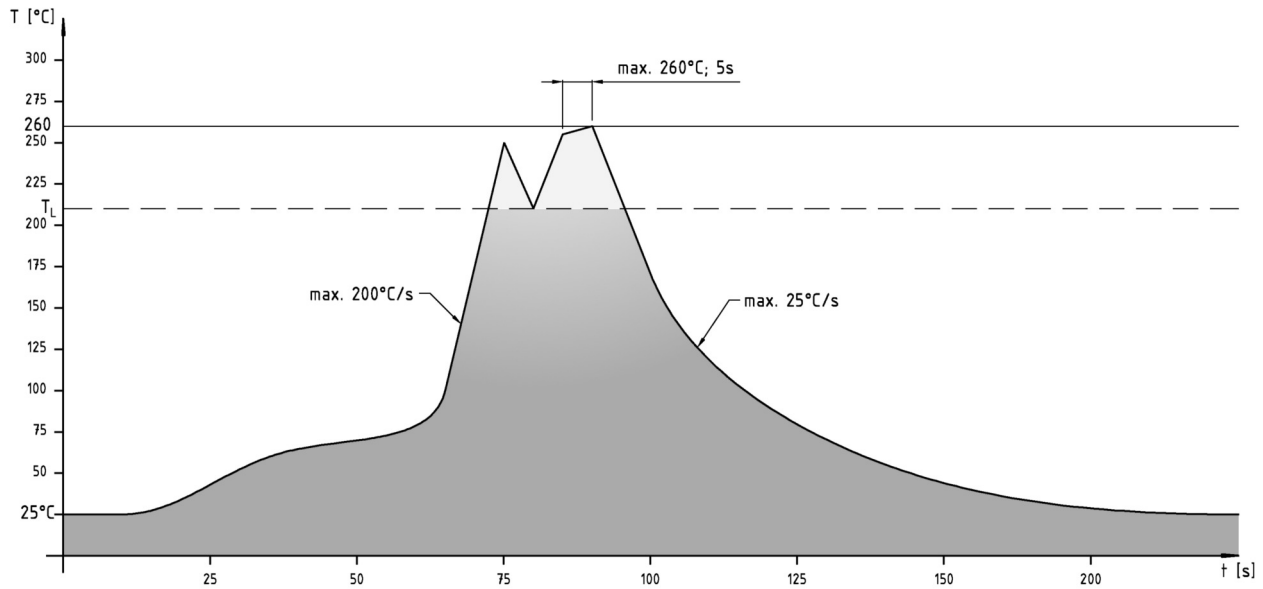
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

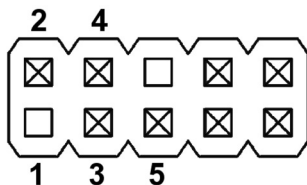
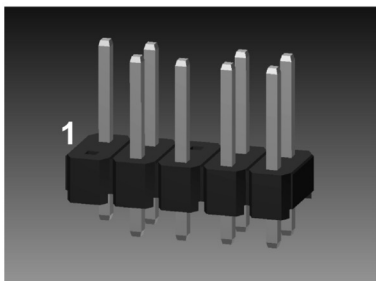
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Gerade Stiftheilen, Sandwich-Stiftheilen

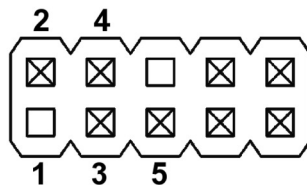
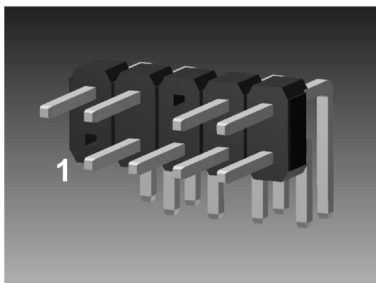
1-, 2-, 3-reihig

Straight Pin Headers, Dual Body Pin Headers
Single, Double, Triple Row



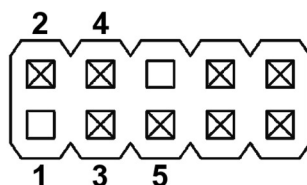
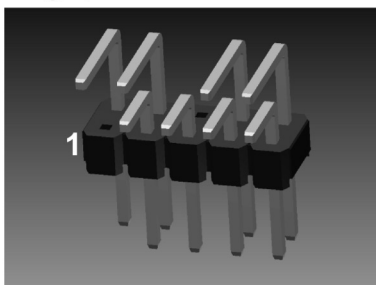
Gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig

Right-angled Pin Headers Single, Double, Triple Row



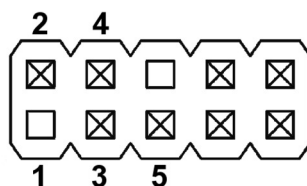
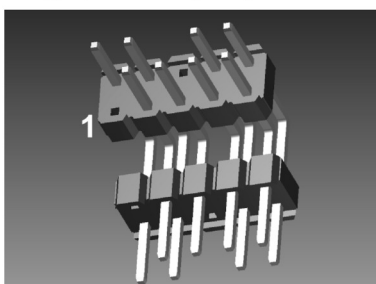
Steckseitig gewinkelte Stiftheilen 1-, 2-reihig

Right-angled Mating Side Pin Headers
Single, Double Row



Gewinkelte Sandwich-Stiftheilen 1-, 2-, 3-reihig

Right-angled Dual Body Pin Headers
Single, Double, Triple Row



Serie / Bestellcode
Series / Order Code

Bestückungsschema bestückt / assembled

Assembly Pattern unbestückt / empty